

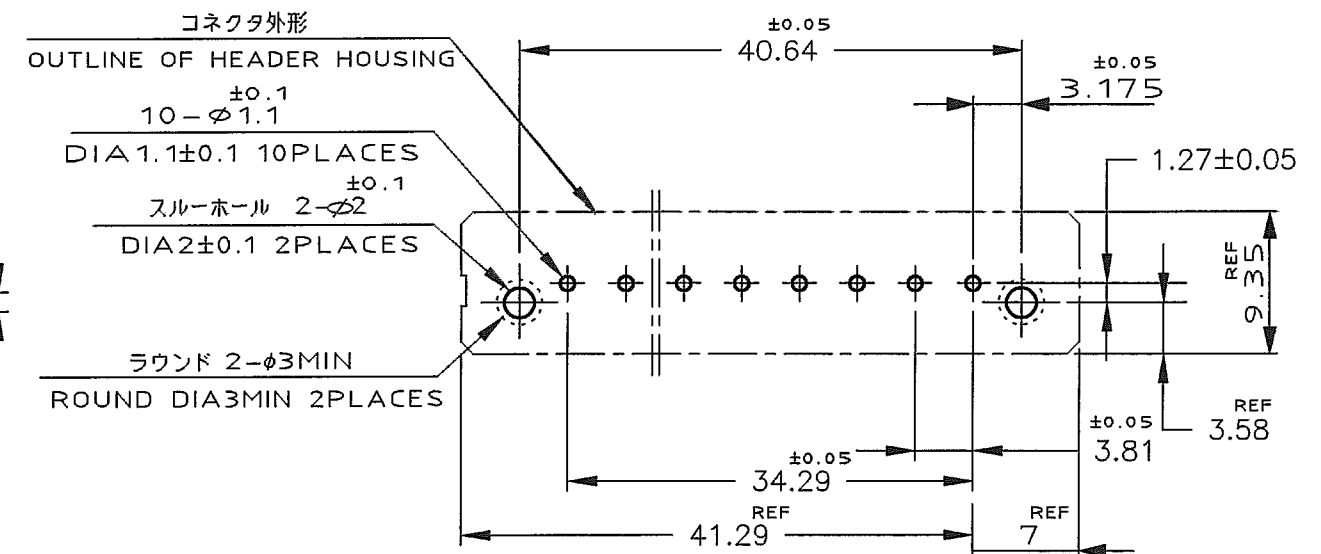
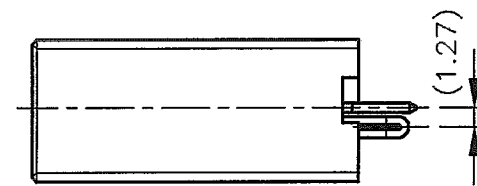
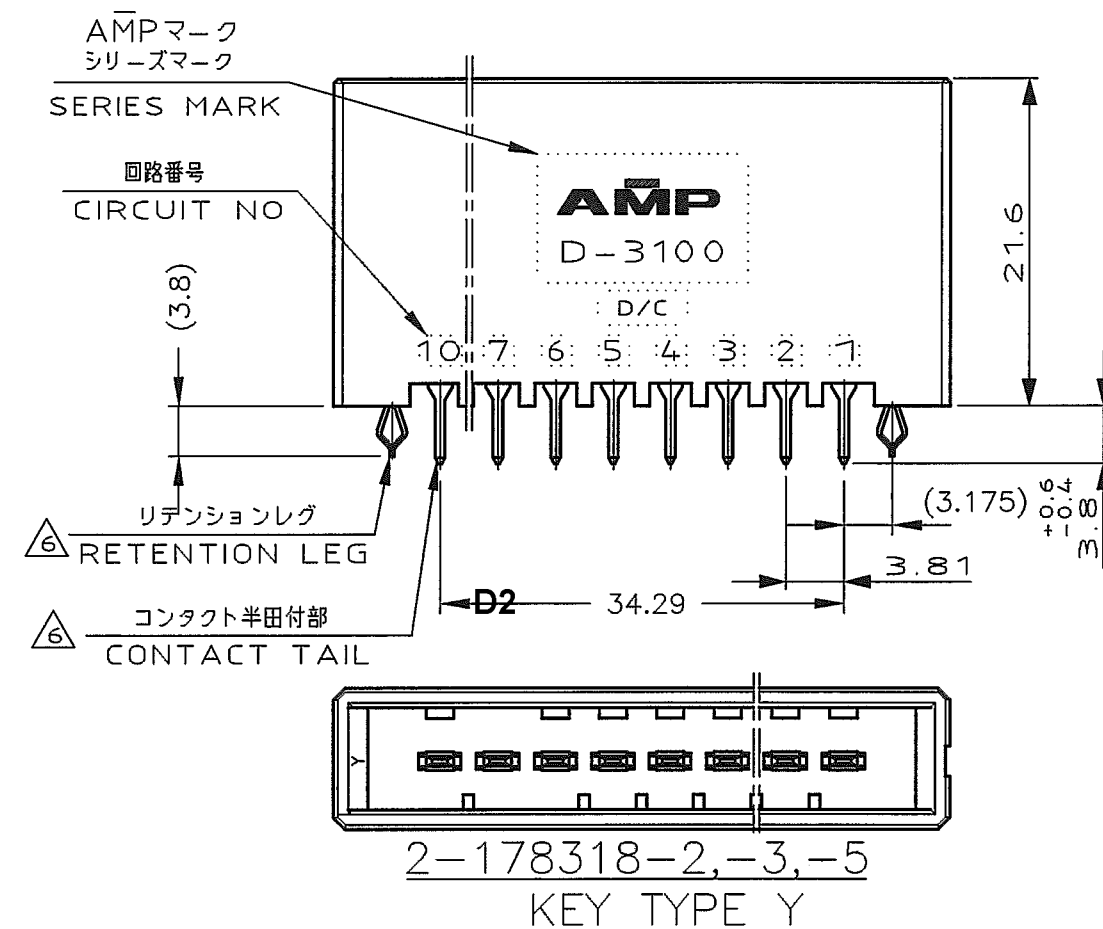
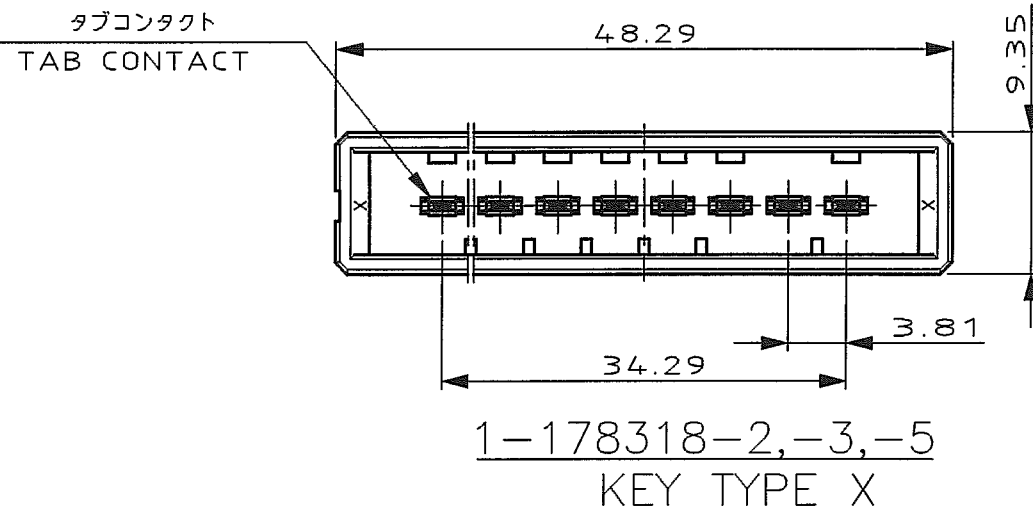
NUMBER 178318



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



推奨基板取付け寸法

PC 基板厚: 1.6 ± 0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO
PLASTIC, POLYESTER

CONTACT: COPPER ALLOY

RETENTION LEG: COPPER ALLOY

2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μ m MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING

3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μ m MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING

4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μ m MIN TIN
PLATED OVER NICKEL

5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

7. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性

ポリエステル樹脂

コンタクト: 銅合金

リテンションレグ: 銅合金

2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μ m MIN金めっき

3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μ m MIN金めっき

4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μ m MINスズめっき

5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき

6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

Y	6	4	2-178318-5	OBSOLETE A
	6	3	2-178318-3	
	6	2	2-178318-2	
X	6	4	1-178318-5	
	6	3	1-178318-3	
	6	2	1-178318-2	
キーイング KEYING	FINISH		製品番号 PART NO.	

D2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	24MAR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

					 TE Connectivity				
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME 10 POS SINGLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100					
mm (AWG -)		mm ϕ							
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		SIZE	LOC	NUMBER	
DR. Y.TANAKA 9 JUN 92		DE. Y.TANAKA 9 JUN 92		10mm以下 : ± 0.3 10mm超 30mm以下 : ± 0.4 30mm超 100mm以下 : ± 0.5 100mm超 : ± 0.5 角 度 : $\pm 3^{\circ}$		A3	J	C- 178318	
CHK. S. MANABE 22 JUN 92		APP. S. MANABE 22 JUN 92				SCALE 2-1		REV. D2	SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面